**DIP炉后AOI设备标书**

**一、投标要求**

1 投标人须仔细阅读招标文件的全部条款，并作为明确响应。

2 招标文件中带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将导致废标。

3 投标报价

3.1 对设备进行报价填写《投标货物数量、价格表》；

3.2 投标报价为设备到需方价（应含运保费）。

4 资质要求：投标人可以是设备制造厂家，也可以是设备授权代理商，代理商需有设备原厂家的有效授权书，并且具有设备技术支持和服务能力。要求提供主流的、且为业界公认成熟的品牌和型号。

5 付款方式：采取T/T方式（签订合同后付30%，凭合格的验收报告付60%，质保期结束后付剩下的10%）。

**二、设备名称、数量及用途**

1） 设备名称与数量：

DIP炉后AOI 1台

★2 设备用途：通过高精度彩色工业相机RGB原理采集产品图像，采取灰度、彩度等多种算法处理图像，准确判定波峰后焊锡不良。

检测项目：连锡、无锡、少锡、多锡、空洞、短路、露铜、假焊等。

1. **主要技术指标和性能**

炉后AOI技术指标

|  |  |
| --- | --- |
| 相机 | 1200/500万像素数字工业相机 |
| 镜头 | 远心镜头 |
| 光源 | 高亮WRGB同轴环形光源 |
| 分辨率 | 15μm(选配10μm) |
| FOV尺寸 | 48.96\*40.96/36\*30mm(10μm:24\*20mm) |
| 检测速度 | <160 ms/FOV |
| 轨道调宽 | 自动调宽 |
| 进板流向 | 左→右/右→左(一键自由切换) |
| 固定轨 | 前轨 |
| 轨道高度 | 900±20 mm /750 ±20 mm |
| PCB尺寸 | 40\*40mm 420\*380mm |
| 板重(最大) | 7KG |
| PCB厚度 | 0.3~5 mm |
| PCB板弯 | <5mm |
| PCB净高 | Top:40mm,Bot:150mm |
| 工艺边 | 3.0 mm |
| 检测项目 | 偏位，缺件，歪斜，立碑，侧立，翻件、错件，极性，无锡、少锡，短路，虚焊，空焊，溢胶， 锡洞，异物，不出脚、锡球、 |
| 操作系统 | Windows 7/10专业版 |
| 电源 | AC220V 50/60Hz,1.5KVA,无需气压 |
| 通讯方式 | SMEMA,ETHERNET |
| 环境要求 | 温度：10~35℃,湿度：35~80%RH(无结霜) |

**四、培训、验收方法**

★1 投标方应免费提供整套设备一年的保修，其中主要部件终身维修，国内有技术服务工程师；有备品、备件仓库并提供终身备品备件；能够及时提供设备故障、维护及应用的技术支持，服务工程师24小时内可到达现场进行服务。

★2 技术资料

投标方需提供使用说明书。

★3 人员培训

在招标方现场进行培训，培训人员食宿自理，招标方提供方便，培训效果应使相关人员熟练掌握设备的操作、编程和维护保养。培训时间根据情况灵活掌握。

4 验收方法

4.1 安装调试

设备的安装调试由投标方负责，招标方提供方便。投标方应提供设备安装工作时间表，并遵守招标方的规章制度。投标方应提供设备具体安装条件。

★4.2 最终验收

最终验收地点在用户现场，双方签署的技术协议中包括验收大纲，确定验收方法和标准。

**五、运输、包装、交货期及交货地点**

1 交货期：合同签订后15天；

★2.卖方提供的产品包装应当符合国家规定或行业通行做法的要求，包装不符合要求或者包装有破损的物品，买方有权拒收。卖方提供的产品包装应足额足量，标有产地、生产厂家、生产日期等必要的、清晰的标识或买方统一要求的标识。包装费用已包括在货物价款内，不另计费。

3 交货地点：中国传感谷。